



## 2020년 MPW 희망공정 지원 가이드

I C D e s i g n E d u c a t i o n C e n t e r

## • 국내외 MPW 희망공정 개요

구분	설계팀 희망공정 (개별 지원)	
지원 내용	설계팀이 희망하는 제작 공정의 칩제작 비용 지원	
지원 공정	설계자 희망 공정 (TSMC, Global foundries 등)	
회차 별 Fab in 가능 기간	HM-2001회차	2020년 6월 ~ 2020년 8월
	HM-2002회차	2020년 9월 ~ 2020년 10월
	HM-2003회차	2020년 11월 ~ 2020년 12월
지원 규모	제작비의 70%(최대 1,500만원)내 지원, 연구실 최소부담금액 300만원 (*지원자 수에 따라 금액은 다소 변동 가능)	
선정 기준	설계 내용(아이디어), 면적활용, 활용 계획 등 (기존 MPW 신청서 양식 사용)	
기술 지원	설계팀이 운영, 필요 시 IDEC 개설 교육 참여 설계 팀 간담회 및 세미나를 통해 설계자 간 교류	
지원 방법	설계에 필요한 모든 절차는 연구실에서 진행 IDEC 지원금은 제작업체에 직접 납부 처리할 수 있도록 설계팀의 협조가 필요	
지원 금액	설계 팀별 제작 공정의 최종 견적서를 확인하고 지원 금액 산정	

# • IDEC 희망공정(HM) 진행 절차

1	2	3	4	5	
모집	선정평가	납부 방법 협의	계약	결과보고	
<b>설계회로설명서 제출</b> • 4쪽 내외 • 지정 양식 사용 • 평가항목 모두 기재	평가결과에 따라 최종 지원여부 확정		계약업체 및 견적서를 제출하여 지원금액 산정 및 계약 방법 협의  <b>(참고)</b> • Tape-out 전 계약 필수! • TSMC 공정의 경우, 공식 에이전시(GUC, 에이직랜드) 대상으로만 계약 가능 • 국내 업체의 경우, 후납 가능 여부 문의	계약 진행  <b>(참고)</b> • 외자-500만원 이상일 경우만 계약 • 내자-1,000만원 이상일 경우만 계약	• 결과보고서 • CDC, JICAS  <b>의무사항 기한</b> • 결과보고서는 칩 수령 후 2개월 이내 • CDC, JICAS는 칩 수령 후 1년 이내
	구분	지원 여부			
	80점 이상	지원 확정			
	80점-70점	발표평가 후 지원 확정			
	70점 미만	탈락			

# • 설계팀 수행 의무 사항

## 설계팀 수행 의무 사항

- 사사문구에 IDEC 지원 받아 칩을 설계했음을 표기
- IP 내용 소개
- 결과보고서 제출 : 칩 수령 후 2개월 이내
- CDC 참여 : 칩 수령 후 1년 이내
- JICAS 게재 : 칩 수령 후 1년 이내

## 의무사항 불이행 시

- 결과보고서 및 CDC 미 참여 시 MPW 참가 신청 불가

### ❖ 사사문구 가이드

#### [국문]

- **MPW 지원받은 경우** : 본 연구는 IDEC에서 MPW를 지원받아 수행하였습니다.
- **EDA Tool 지원받은 경우** : 본 연구는 IDEC에서 EDA Tool를 지원받아 수행하였습니다.

#### [영문]

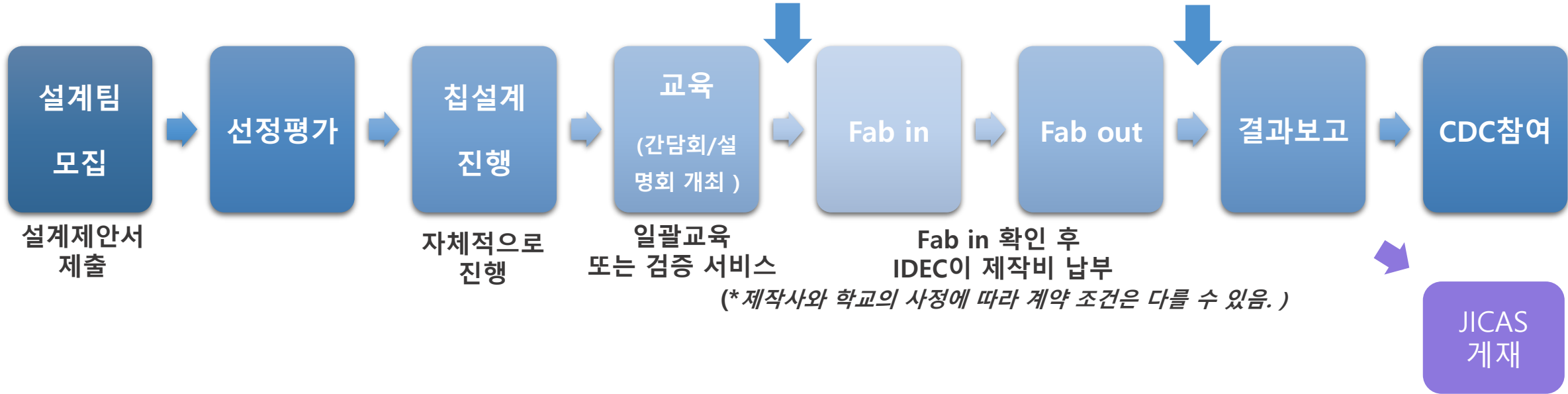
- **MPW 지원받은 경우** : The chip fabrication was supported by the IC Design Education Center(IDEDEC), Korea.
- **EDA Tool 지원받은 경우** : The EDA tool was supported by the IC Design Education Center(IDEDEC), Korea.
- **MPW와 EDA Tool 모두 지원받은 경우** : The chip fabrication and EDA tool were supported by the IC Design Education Center(IDEDEC), Korea.

# • 국내외 MPW 희망공정 지원 세부 절차



- DB제출서 작성(IP 소개자료)
- 계약 체결을 위한 협의(견적서 제출)

- 칩사진 제출(IDECE에 제출)



설계제안서  
제출

자체적으로  
진행

일괄교육  
또는 검증 서비스

Fab in 확인 후  
IDECE이 제작비 납부

(\* 제작사와 학교의 사정에 따라 계약 조건은 다를 수 있음. )

- Fab out 후 1년 이내 게재
- JICAS는 설계 과정과 검증 내용을 중심으로 작성

# • 국내외 MPW 희망공정 지원 세부 절차- 선정평가

## 평가위원 및 평가방법

- 평가위원 : 설계 참여 교수와 이외 설계 전문가를 위촉하여 평가
- 평가방법 : 설계제안서를 평가
- 평가결과 : 회로설명서의 평가 결과가 저조한 팀은 탈락

## 평가 항목 및 배점

- 1팀당 5~6명의 평가위원으로 구성하여 평가 진행
- 평가자료 : 설계회로설명서
- 평가 항목 (100점)
  - 1) 디자인의 우수성 30점
  - 2) 회로설계방법 (단계별로 사용한 CAD Tool 등) 15점
  - 3) Chip 수령 후 검증방법 15점
  - 4) Design size(공간활용도) 20점
  - 5) 활용계획 10점
  - 6) 평가위원들의 주관적 점수 10점

### ❖ 유의사항

평가 후 제안서 내용 **변경 불가**  
 변경 필요시, 사유서 제출 **필수!**

## 선정 결과 발표

- IDEC 홈페이지 MPW 신청 내역에서 채택여부 확인

**마이페이지**

- 회원수정
- 비밀번호변경
- IDEC 참여내역
- 교육신청내역
- VOD신청내역
- WG참여내역
- MPW신청내역

### IDEC 참여내역

홈 | 마이페이지 | IDEC 참여내역 | MPW신청내역

“한국 반도체산업의 경쟁력”  
 IDEC에서 설계인력양성의 발판을 마련하겠습니다.



### MPW신청내역

회사	공정	모집구분	신청일자	채택여부	공정상태
MS180-1505회	매그나칩반도체/SK하이닉스 0.18 $\mu$ m	우선모집	2015-02-23	채택	실제작 대기(2015.12.21)
	NDA제출 제출	DB제출 제출	결과보고제출	CDC참여	

# • 국내외 MPW 희망공정 지원 세부 절차 - Fab in 시 처리 내용

## DB 제출서 작성

- IP 내용 보고 : 소개 내용은 10줄 내로 기재, 설계 layout
- 제안서 최종 내용으로 변경하여 업로드
- IP 보고 내용은 칩제작비 납부 시 증빙서류로 사용

## 공정사와 계약 체결 관련

- 최소 계약 1개월 전에 IDEC에 최종 견적서 제출 (금액 확인)
- 계약서류 작성에 대한 반드시 논의 후 진행
- 확인 절차를 거쳐 참가비를 처리함.

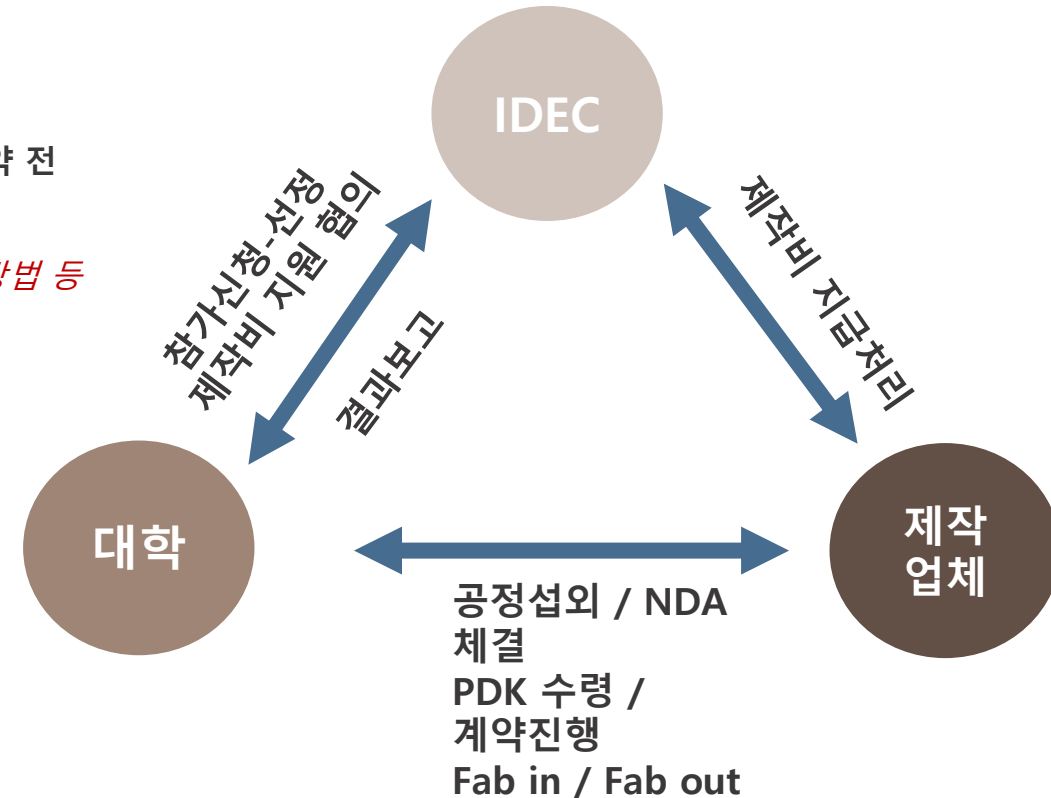
# • 국내외 MPW 희망공정 지원 세부 절차 - 칩제작비 지원 방법

## 지원 절차 (\*지원 방식은 내부 상황에 따라 조정될 수 있음.)

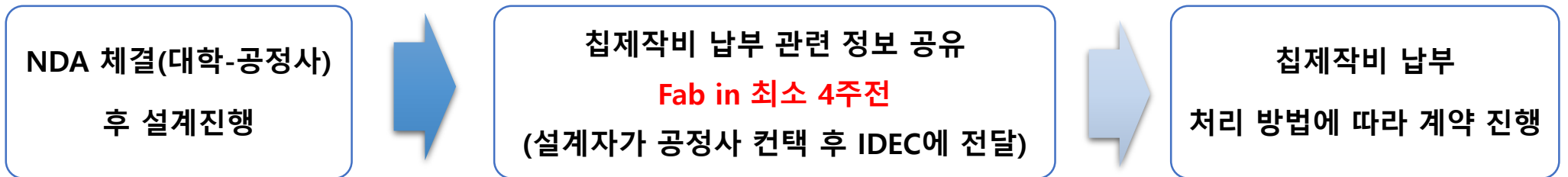
- 1) 견적서 제출 (제작업체로 받은 전체 금액이 포함된 견적서를 IDEC에 제출)- 계약 전  
**(Fab in 5주전에 제출해야 지원을 위한 계약 진행이 원활합니다.)**
- 2) 대학-IDEC-업체 간 계약 체결 조건 확인 - 계약체결전 협의
- 3) 계약 조건 결정된 상태에서 계약 체결 진행 (\*국내/국외 에이전시에 따라 계약 방법 등이 다름. 또한 학교의 사정에 따라 조정되는 경우가 있음.)
- 4) Fab in 전 계약 체결 완료
- 5) 대금 결제는 Fab in 과 함께 선결재를 원칙으로 하고 있음.  
단, 계약 조건에 따라 상이할 수 있음.

## 칩제작비 지원을 위한 증빙 요청 서류

- 지급 처리에 필요한 증빙 서류  
: 학교와 업체의 계약 체결서, IP 제출서, 견적서



## 칩제작비 납부 지원 절차



(\* 제작사와 학교의 사정에 따라 계약 조건은 다를 수 있으므로 계약 진행시 협의하여 지원하게 됨.)

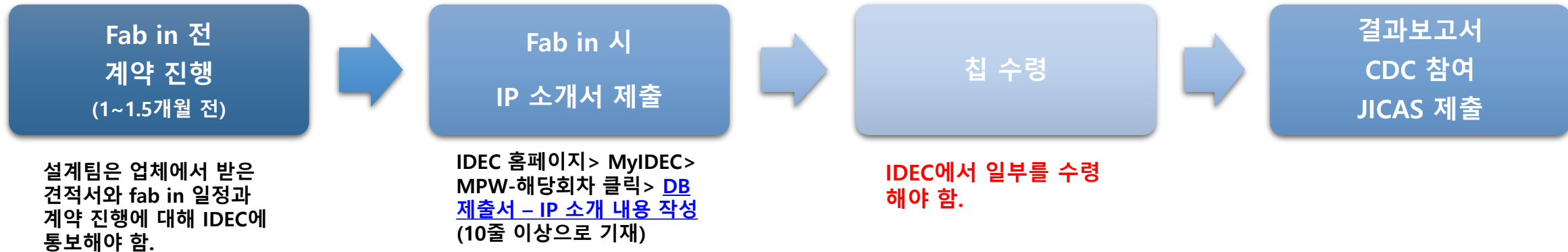


# • 국내외 MPW 희망공정 지원 세부 절차 - 칩제작비 지원 방법

## 지원 조건

- 칩제작비의 70%(최대 1,500만원. 설계자 최소 부담금 300만원)
- 연구실 별 연간 지원 횟수는 예산 상황에 따라 제한될 수 있음.
- 지원된 칩에 2개 이상의 IP가 포함된 경우 IP 내용에 대해서는 모두 등록을 요청함.

## 참여 절차



## 칩제작비 지원 방법

거래 업체 구분	필요 서류	계약 시 필요 내용(IDEC에 전달해 주실 내용)	비고
국내 에이전시	거래업체에 계약서와 견적서를 수령하여 IDEC에 전달(계약 1.5개월 전)	<b>필요 서류 발송시 전달</b> 1) 업체정보 : 업체명, 담당자/연락처(전화, 메일) 2) 칩수령 방법 : IDEC에서 전부 수령 또는 1/2씩 수령 3) 연구실 계약 담당자 정보 : 이름과 연락처	<b>칩수령 관련</b> : KAIST에서 계약한 칩은 반드시 KAIST에서 일부 수령이 되어야 함.(검수 과정 필수)
외국 에이전시	거래 업체에 견적서를 2개(대학, IDEC)로 분리 요청하여 IDEC에 전달 (계약 1.5개월 전 제출)	<b>필요 서류 발송시 전달</b> 1) 업체정보 : 업체명, 담당자/연락처(전화, 메일) 2) 칩수령 방법 : IDEC에서 전부 수령 또는 1/2씩 수령 3) 연구실 계약 담당자 정보 : 이름과 연락처	

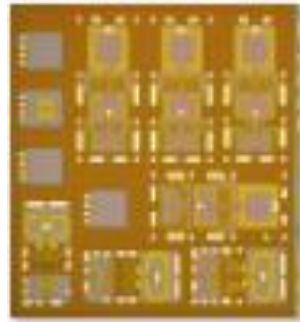
# • 국내외 MPW 희망공정 지원 세부 절차 - Fab out 후 절차

## 칩사진 제출 : 칩수령 후 7일 이내 제출

- 칩사진과 칩 수령 시 현물 내역 (지급 내역에 증빙 서류임.)

## 제출 방법

- 담당자에게 이메일로 발송
- 파일명 : 회차\_대학\_설계자명.jpg(ex: MPWA-1801\_IDEC\_이의숙, jpg)



# • 국내외 MPW 희망공정 지원 세부 절차 - 결과보고

## 결과보고서 제출

칩제작 완료 후 2개월 이내

양식 : 제공(기존 MPW 결과보고서와 동일함.)

제출 방법 : IDEC 홈페이지 > MYIDEC > 희망공정 신청내역 > 참여회차 클릭 > 결과보고 탭 내 세부 내역 기재 및 결과보고서 업로드

## CDC 참여

Fab out일로 부터 1년 이내 참가해야 함.

개최 CDC : KCS(2월), IDEC Congress(6월), ISOCC(11월)

*\* Congress와 ISOCC CDC 참여한 것은 논문으로 인정되지 않음.*

참여 형태 : 논문 제출 / 포스터 전시

## JICAS 제출(1년 이내 요청)

제출 기한 : Fab out 후 1년 이내

결과보고서 제출 내역 확인 후 제출을 요청할 예정

I C Design Education Center

**THANK YOU**